

〈対面開催〉

## 2025 年度 半導体 EMC セミナー

「半導体・システム・自動車：3 階層で考える EMC の最新動向と技術解説」

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対しまして格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

JEITA 半導体システムソリューション技術委員会・半導体 EMC サブコミティ (SC) では、半導体デバイスの EMC (Electromagnetic Compatibility : 電磁環境両立性) についてのご理解を一層深めていただくために、2015 年度に始まり毎年恒例となりました本セミナーを今年度も開催します。2025 年度のセミナーは対面・web のハイブリット形式とし、聴講料有料にて行います。本セミナーでは、最近、半導体・システム・自動車の 3 階層にわたる活動が出来ていることを受け、まずトヨタ自動車/野島様から、自動車会社が考える EMC について『SDV における EMC』と題して報告頂き、システム階層並びに半導体階層への課題の投げ掛けを頂きます。次にシステム階層から見た EMC について、当 SC から『電子制御ユニットレベルの EMC 設計フロー』と題して報告します。更に『半導体 EMC\_IEC 国際規格の最新動向』と題して当 SC から IEC 国際規格の半導体 EMC 評価方法の概要と、変遷著しい規格の最新動向を報告します。そして最後に「半導体・システム・自動車：3 階層のつながりとそのあり方」と題して、EMC 課題を考える場としてまとめます。

時節柄、業務ご多用のことと存じますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

敬 具

### 【開催概要】

日 時 : 2026 年 2 月 24 日 (火) 12:30~16:45 【受付開始 11:30】

場 所 : 連合会館 404 号室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 2 番 11 号

JR 中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口（徒歩 5 分）

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B3 出口（徒歩 0 分）等

<https://rengokaikan.jp>

開催方法 : 対面並びに Web 開催 (対面会場 : 定員 30 名、Web : 定員なし)

主 催 : (一社) 電子情報技術産業協会／半導体システムソリューション技術委員会

参 加 費 : [JEITA 会員] 9,000 円(税込)／1 名 (配布資料含む)

[JEITA 非会員] 12,000 円(税込)／1 名 (配布資料含む)

[学生] 2,000 円(税込)／1 名 (配布資料含む)

[特別参加] 14,000 円(税込)／2 名 (配布資料含む)

\*会員・非会員の区分は下記よりご確認下さい (特別参加の場合、区分不要)。

<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

\*\*終了後に対面会場近くで交流会 (1,000 円(税込)／1 名) を開催致します。

申込方法 : 下記サイトよりお申込みください。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/453/form>

お申込後、登録頂いたメールアドレス宛に「受講票」と「振込案内」を送付致します。お申込後のキャンセルはお断りさせて頂いています。

申込期限 : 2026 年 2 月 13 日 (金) (対面会場の方、定員になり次第、〆切らせて頂きます)

プログラム：司会進行／JEITA 半導体 EMC-SC 主査 東芝デバイス＆ストレージ（株） 富島 敦史

時間	内容
12:30～12:35	開会挨拶・趣旨説明 JEITA/半導体 EMC-SC 広報 WG リーダ 長沼 健 [ルネサスエレクトロニクス株式会社]
12:35～13:35 【特別講演】	SDV における EMC トヨタ自動車株式会社 電子性能開発部/電子性能開発室/主査 野島 昭彦 様 CASE と SDV における EMC 開発の取り組みを紹介します。 ・自動車の EMC の国際規格、基準動向 ・IC～ECU～SDV の EMC 開発 JASO D019/D020 IC/素子の EMC 等価性試験 ・JASO TP23002/25001 自動車用電子部品の標準試験とその CAE ガイド
13:40～14:35	電子制御ユニットレベルの EMC 設計フロー JEITA/半導体 EMC-SC 副主査 林 靖二 [キヤノン株式会社] 電子制御ユニットの開発においては、LSI、Package、Board の各要素の全体最適化と性能確保の見通しを設計自由度が高い開発上流で得る、いわゆるフロントローディング化が重要です。本報告では、JEITA で考える EMC 性能確保のための設計フローについて、半導体への期待と合わせてご紹介します。
14:40～16:00	半導体 EMC IEC 国際規格の最新動向 JEITA/半導体 EMC-SC 主査 富島 敦史[東芝デバイス＆ストレージ（株）]  国立大学法人 名古屋工業大学 未来通信研究センター 和田 修己 客員教授  車載システム開発において、IEC で規格化されている半導体単体の EMC 試験方法に基づく EMC 測定結果の活用方法が近年注目されてきています。 これまで解説されていなかった半導体 EMC 試験方法規格化当初の目的や成り立ちを振り返るとともに、その活用法に対して、IEC での審議最新動向や注意すべき項目などについて概説します。
16:05～16:30	全体のまとめ(半導体・システム・自動車：3階層のつながりとそのあり方)
16:30～16:40	質疑応答・アンケート記載
16:40～16:45	閉会のあいさつ JEITA/半導体 EMC-SC 副主査 林 靖二 [キヤノン株式会社]
17:15～19:15	交流会 (1,000 円／名、申込 URL よりお申込み下さい) セミナー終了後、講師および JEITA 半導体 EMC-SC 委員との情報交換会を企画しました。セミナーでは聞けなかった内容の確認や EMC に関する話題を共有する場として活用していただければ幸いです。

■運営事務局・各種お問合せ先

一般社団法人 電子情報技術産業協会

事業推進戦略本部 事業推進部 担当：岩渕・遠山

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル 4階

E-mail : [device3@jeita.or.jp](mailto:device3@jeita.or.jp)

■個人情報保護について

※ご参加いただきました方の個人情報は、本セミナーの受付、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用致します。これら以外の目的で使用することはございません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

■連合会館への電話について

連合会館から要請があり、連合会館に直接電話して本件に関する問い合わせをするのはお控え頂きますようお願い致します。